



令和3年(2021年)7月期 第2四半期 決算説明会

サムコ 株式会社

証券コード: 6387

本資料の著作権その他の一切の権利は、サムコ 株式会社に属しております。

複製、転送、第三者への配布等を無断で行わないようお願い申し上げます。

会社概要

- ・商 号 サムコ 株式会社 (証券コード:6387)
- ・代 表 者 代表取締役会長兼CEO 辻 理
代表取締役社長兼COO 川邊 史
- ・設 立 1979年9月
- ・事業内容 半導体等電子部品製造装置の製造・販売
- ・資 本 金 16億6,368万円
- ・従 業 員 172名(役員、パートタイマーを除く 2021年1月31日現在)
- ・営 業 拠 点 本社(京都)・東日本(東京)・東海・つくば・福岡
台湾(新竹・台南)、中国(上海・北京)、韓国(水原)、
シンガポール、マレーシア(ペタリングジャヤ)、
米国(カリフォルニア・ニュージャージー)、リヒテンシュタイン
本社研究開発センター、オプトフィルムス研究所(米国)
- ・研究拠点

本資料の著作権その他の一切の権利は、サムコ 株式会社に属しております。

複製、転送、第三者への配布等を無断で行わないようお願い申し上げます。

グローバルネットワーク



本資料の著作権その他の一切の権利は、サムコ 株式会社に属しております。

複製、転送、第三者への配布等を無断で行わないようお願い申し上げます。

国内拠点

京都

- ① 本社
- ② 研究開発センター
- ③ 製品サービスセンター
- ④ 生産技術研究棟
- ⑤ 第2研究開発棟
- ⑥ 第2生産技術棟

福岡営業所



国内拠点 京都



本資料の著作権その他の一切の権利は、サムコ 株式会社に属しております。

複製、転送、第三者への配布等を無断で行わないようお願い申し上げます。

主要製品群

薄膜形成



CVD (Chemical Vapor Deposition) 装置
原料ガスを気化した後、基板の上に堆積させ、半導体膜、絶縁膜などを形成する装置。



微細加工



ドライエッチング装置
各種半導体基板上の薄膜をはじめ微細加工が必要な材料を加工する装置。



精密洗浄



ドライ洗浄装置
反応性の気体やUV/オゾンを用いて、プラスチックパッケージや電子部品をドライ洗浄する装置。



21/7月期第2Qの実績

(2020.8.1 ~ 2021.1.31)

本資料の著作権その他の一切の権利は、サムコ 株式会社に属しております。

複製、転送、第三者への配布等を無断で行わないようお願い申し上げます。

21/7月期第2四半期(累計)業績

□受注高 30.5億円(前年同期比△3.9%)

- 国内受注高16.9億円、海外受注高13.6億円。

□売上高 22.7億円(前年同期比△22.1%、当初計画比△5.2%)

- 計画24.0億円に対し、5.2%未達。
- 前事業年度後半の受注減少を受け、売上高は低調に推移。

□営業利益 2.5億円(前年同期比△45.2%、当初計画比+14.6%)

- 第1四半期の赤字決算から反転。
- 売上高総利益率が向上し、販管費は減少。
- 各利益(営業利益、経常利益、純利益)は計画を上回る。

21/7月期第2Q(累計) 実績報告

(単位:百万円)

	(参考) 20/7期2Q	21/7月期2Q			
		当初計画	実績	前年同期比 増減率	計画比 増減率
売上高 Net Sales	2,922	2,400	2,276	△22.1 %	△5.2 %
売上総利益 Gross Profit	1,434	—	1,169	△18.5 %	—
売上高総利益率 Gross Profit Ratio	49.1 %	—	51.4 %	—	—
営業利益 Operating Profit	460	220	252	△45.2 %	14.6 %
営業利益率 Operating Profit Ratio	15.7 %	9.2%	11.1 %	—	—
経常利益 Ordinary Profit	471	220	262	△44.3 %	19.4 %
当期純利益 Net Income	341	150	191	△44.1 %	27.3 %

- 売上総利益率51.4%へ改善。
- 営業利益、経常利益、当期純利益で計画を上回った。

21/7月期第2Q 装置別売上高

(単位:百万円)

	20/7月期2Q		21/7月期2Q		
	売上高	構成比	売上高	前年同期比 増減率	構成比
CVD装置	634	21.7 %	296	△53.4 %	13.0 %
エッティング装置	1,395	47.8 %	1,127	△19.2 %	49.5 %
洗浄装置	490	16.8 %	352	△28.1 %	15.5 %
部品・メンテナンス	401	13.7 %	500	24.6 %	22.0 %
Total	2,922	100.0 %	2,276	△22.1 %	100.0 %

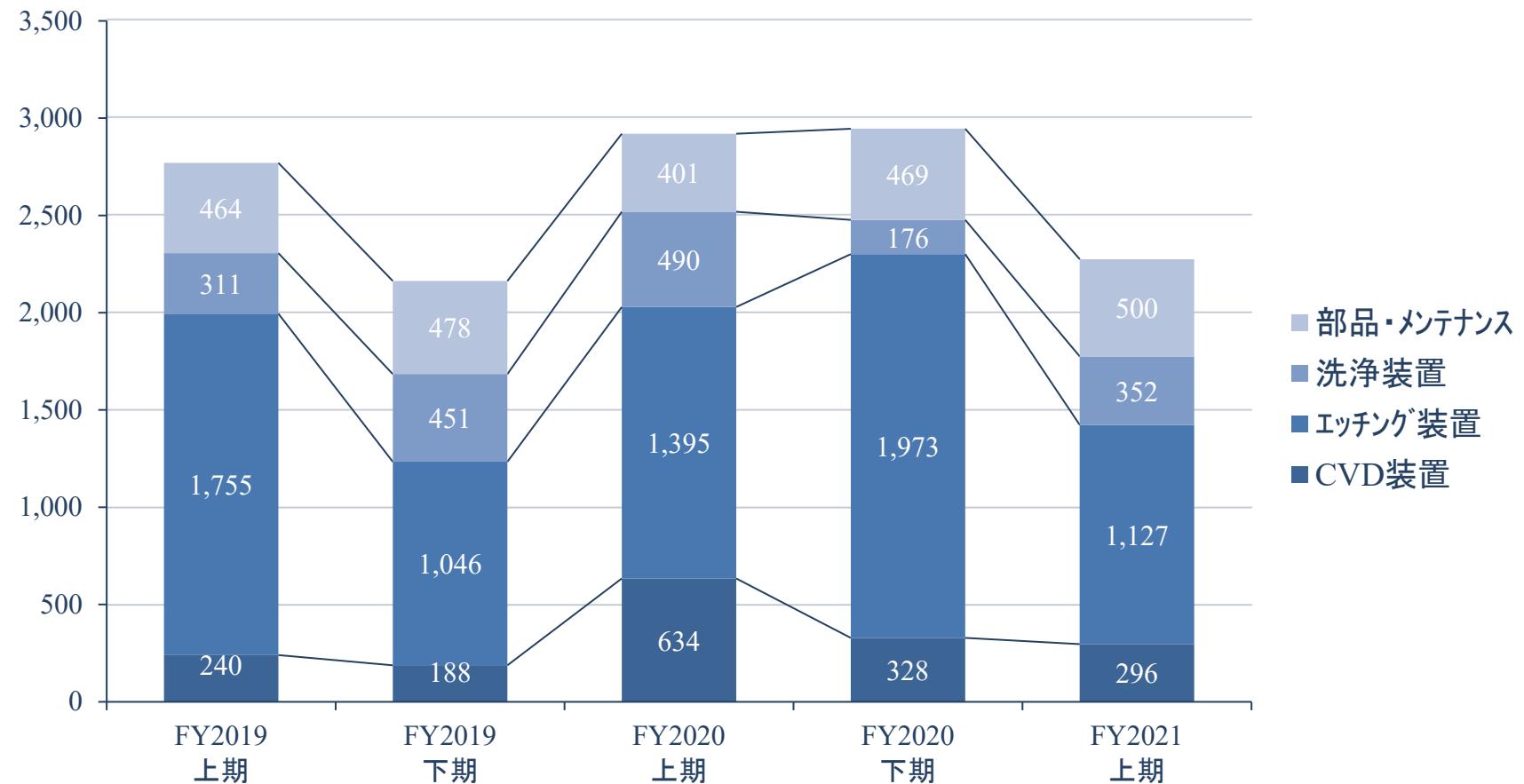
【CVD装置】電子部品分野のセンサ向け、オプトエレクトロニクス分野のLD向けの販売。

【エッティング装置】電子部品分野の高周波フィルタ向けの販売が引き続き堅調。

【部品・メンテナンス】主に国内の生産機向けの消耗部品等の売上が増加。

装置別売上高 (上期、下期実績)

(単位:百万円)



本資料の著作権その他の一切の権利は、サムコ 株式会社に属しております。

複製、転送、第三者への配布等を無断で行わないようお願い申し上げます。

21/7月期第2Q 分野別売上高

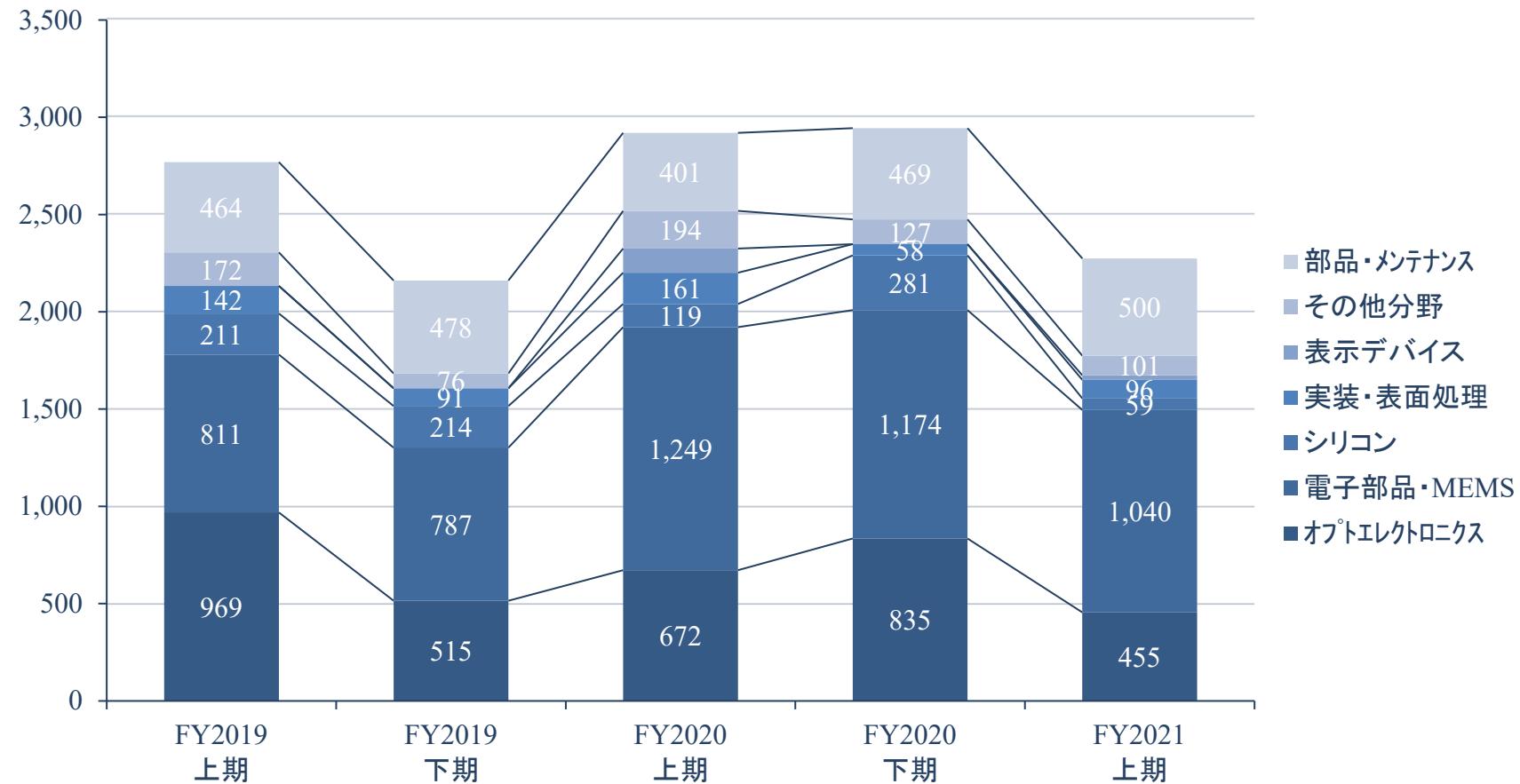
(単位:百万円)

	20/7月期2Q		21/7月期2Q		
	売上高	構成比	売上高	前年同期比 増減率	構成比
オプトエレクトロニクス分野	672	23.0 %	455	△32.3 %	20.0 %
電子部品・MEMS分野	1,249	42.7 %	1,040	△16.7 %	45.7 %
シリコン分野	119	4.1 %	59	△49.9 %	2.6 %
実装・表面処理分野	161	5.5 %	96	△40.5 %	4.2 %
表示デバイス分野	124	4.3 %	23	△81.4 %	1.0 %
その他分野	194	6.7 %	101	△47.9 %	4.5 %
部品・メンテナンス	401	13.7 %	500	24.6 %	22.0 %
Total	2,922	100.0 %	2,276	△22.1 %	100.0 %

【電子部品・MEMS分野】 高周波フィルタ、各種センサ向けが堅調。

分野別売上高 (上期、下期実績)

(単位:百万円)



本資料の著作権その他の一切の権利は、サムコ 株式会社に属しております。

複製、転送、第三者への配布等を無断で行わないようお願い申し上げます。

21/7月期第2Q 用途別売上高

(単位:百万円)

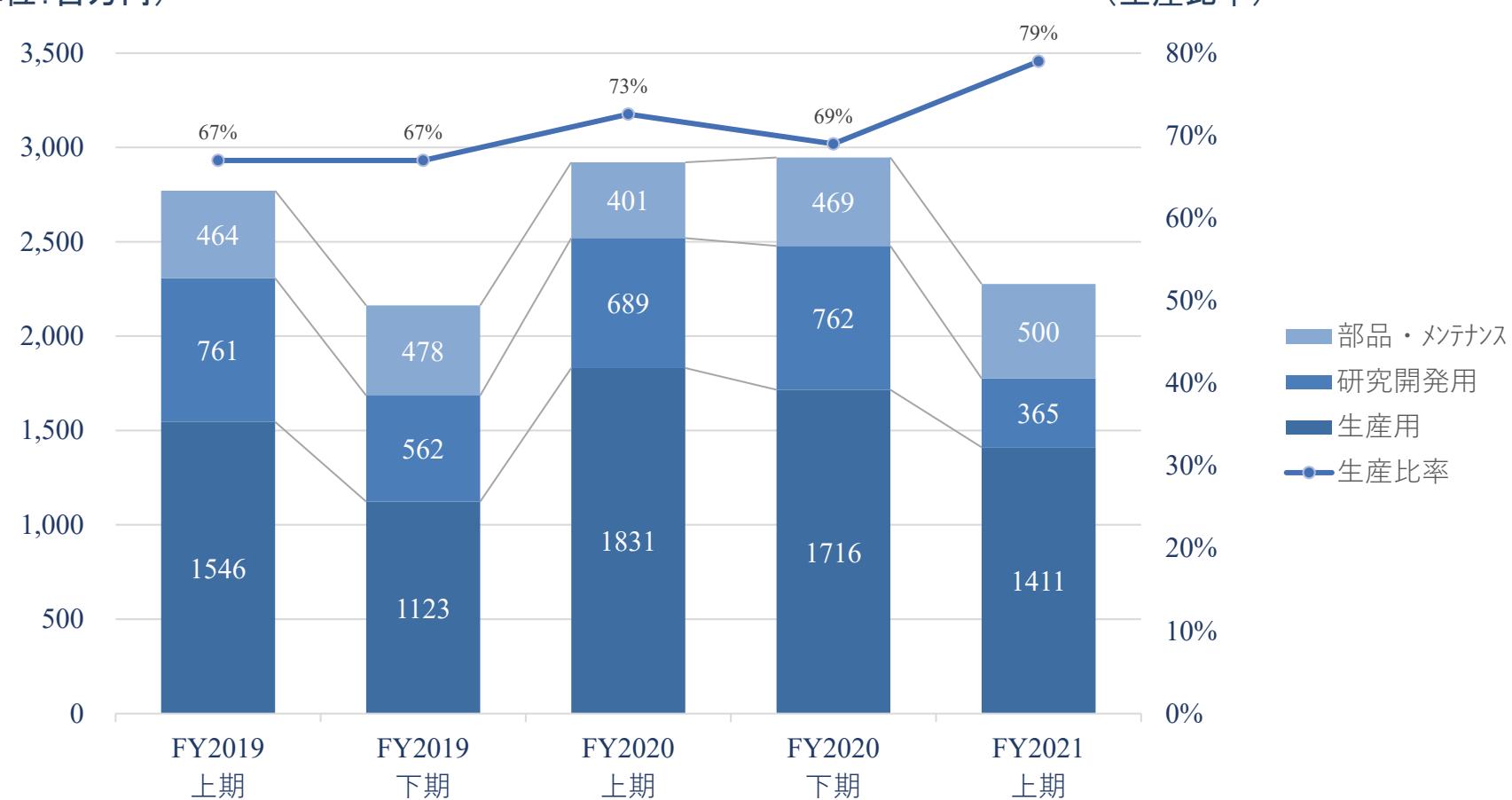
	20/7月期2Q		21/7月期2Q		
	売上高	構成比	売上高	前年同期比 増減率	構成比
生産用	1,831	62.7 %	1,411	△23.0 %	62.0 %
研究開発用	689	23.6 %	365	△47.0 %	16.0 %
部品・メンテナンス	401	13.7 %	500	24.6 %	22.0 %
Total	2,922	100.0 %	2,276	△22.1 %	100.0 %

【生産用】 高周波フィルタ向けが738百万円、センサ向け231百万円と堅調。

【研究開発用】 LD向け、パワーデバイス向け、バイオセンサー向け等、幅広い分野に販売

用途別売上高 (上期、下期実績)

(単位:百万円)



本資料の著作権その他の一切の権利は、サムコ 株式会社に属しております。

複製、転送、第三者への配布等を無断で行わないようお願い申し上げます。

21/7月期第2Q 地域別売上高

(単位:百万円)

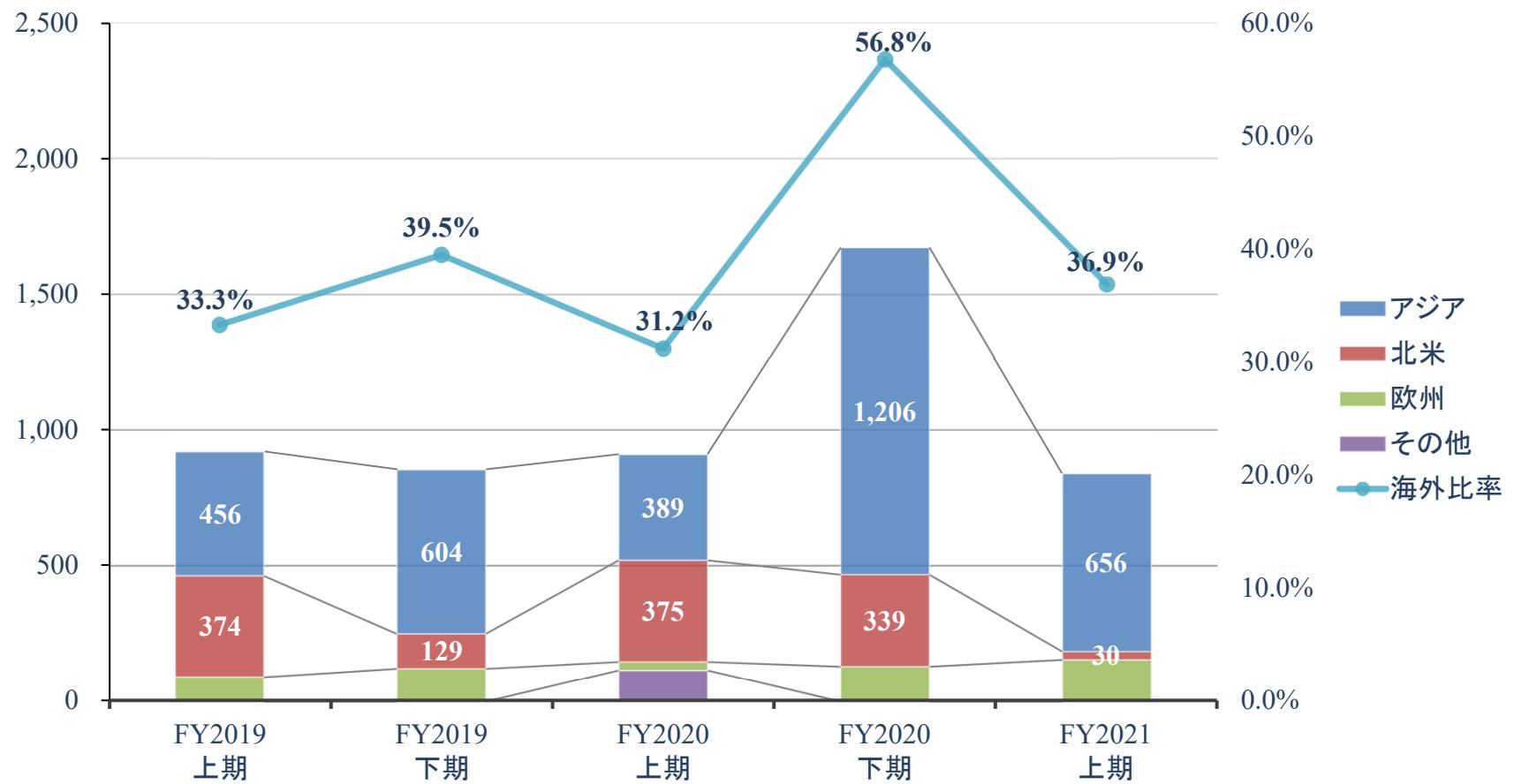
	20/7月期2Q		21/7月期2Q		
	売上高	構成比	売上高	前年同期比 増減率	構成比
国内	2,011	68.8 %	1,435	△ 28.6 %	63.1 %
アジア	389	13.3 %	656	68.6 %	28.8 %
北米	375	12.9 %	30	△ 91.8 %	1.4 %
欧州	31	1.1 %	153	386.9 %	6.7 %
その他	114	3.9 %	—	—	—
(海外合計)	910	31.2 %	840	△ 7.7 %	36.9 %
Total	2,922	100.0 %	2,276	△ 22.1 %	100.0 %

- 海外売上高比率は36.9%(通期計画46.7%)。
- アジア市場は、シンガポール282百万円、台湾219百万円、韓国80百万円等、堅調。
- アメリカ市場がコロナの影響で低迷し、回復は下期以降。

地域別売上高 (上期、下期実績)

(単位:百万円)

(海外売上高比率)

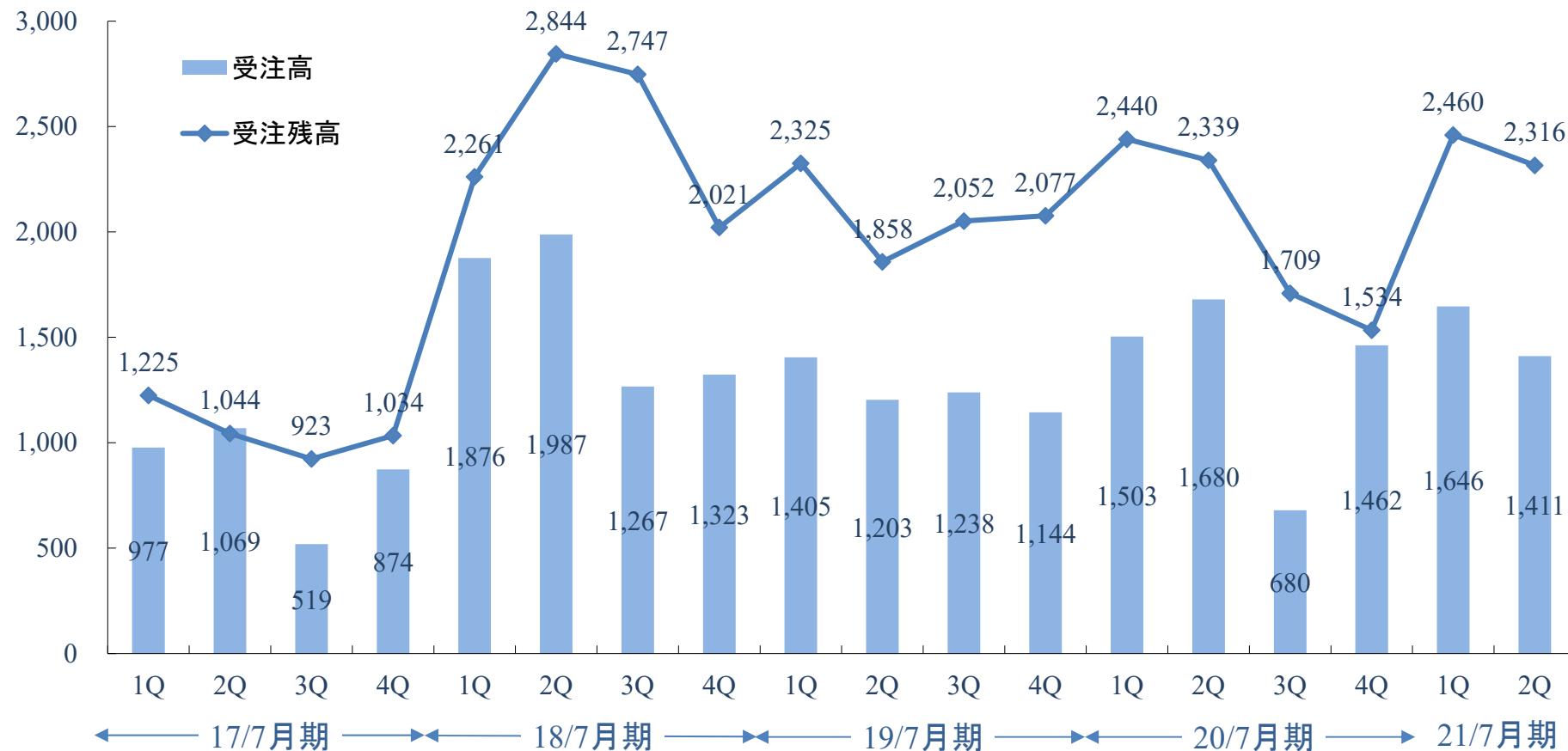


本資料の著作権その他の一切の権利は、サムコ 株式会社に属しております。

複製、転送、第三者への配布等を無断で行わないようお願い申し上げます。

受注環境（受注高、受注残高）の変化

（単位：百万円）



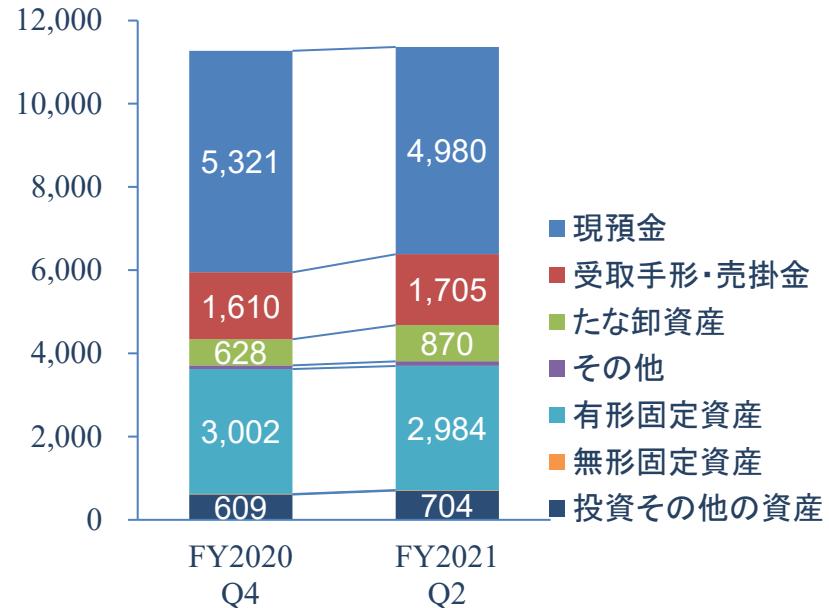
本資料の著作権その他の一切の権利は、サムコ 株式会社に属しております。

複製、転送、第三者への配布等を無断で行わないようお願い申し上げます。

貸借対照表

(単位:百万円)

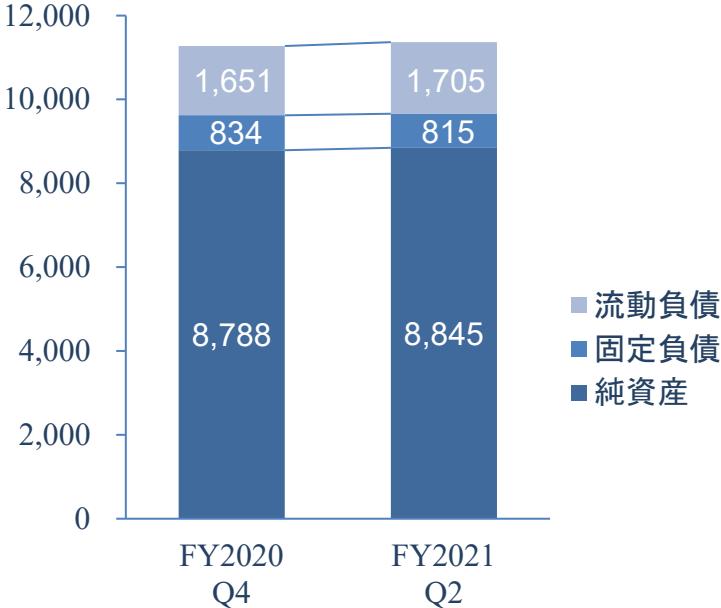
資産



- たな卸資産241百万円増、
- 受取手形・売掛金94百万円増
- 現金及び預金340百万円減

(単位:百万円)

負債・純資産



- 買掛金208百万円増
- 前受金205百万円増
- 未払法人税等183百万円減
- 未払金60百万円減

21/7月期上半期トピックス

マイクロLED製造装置

中国深センの大手家電・電子機器メーカーである康佳(Konka)グループへ販売したマイクロLED製造用のエッティング装置、CVD装置の立上完了。



出典:康佳グループ スマートウォッチ

21/7月期上半期トピックス

新型コロナウイルス不活化技術を完成

2020年6月、『新型コロナウイルス感染症対策技術結集事業』として2,000万円の補助金の交付。

この度、新型コロナウイルスをAqua Plasma®を用いて不活化する技術を完成させ、東京大学生産技術研究所で効果確認を行い*、本事業を終了。今後は、本技術を当社のヘルスケア事業に取り入れて事業化を図る予定。

*エンベロープと一本鎖RNAを持つ新型コロナウイルスと同様のレンチウイルスを用いて効果確認を行いました。



新型コロナウイルス感染症への対応

2021年3月12日時点で、社員および家族の感染者発生は無し。

① 出張、会議、営業活動

- WEB会議、TV会議を活用。
- 時差出勤、テレワークの一部実施。
- 対面営業が減少し、リモート活動が増加。

② 出荷済装置の立上・サポート

- 海外では現地サービス人員が活躍。
- 装置デモ、出荷前立会などを一部リモート対応。
- 本社(京都)からリモートでの装置立上を実施。

21/7月期事業見通し

21/7月期 目標数値

(単位:百万円)

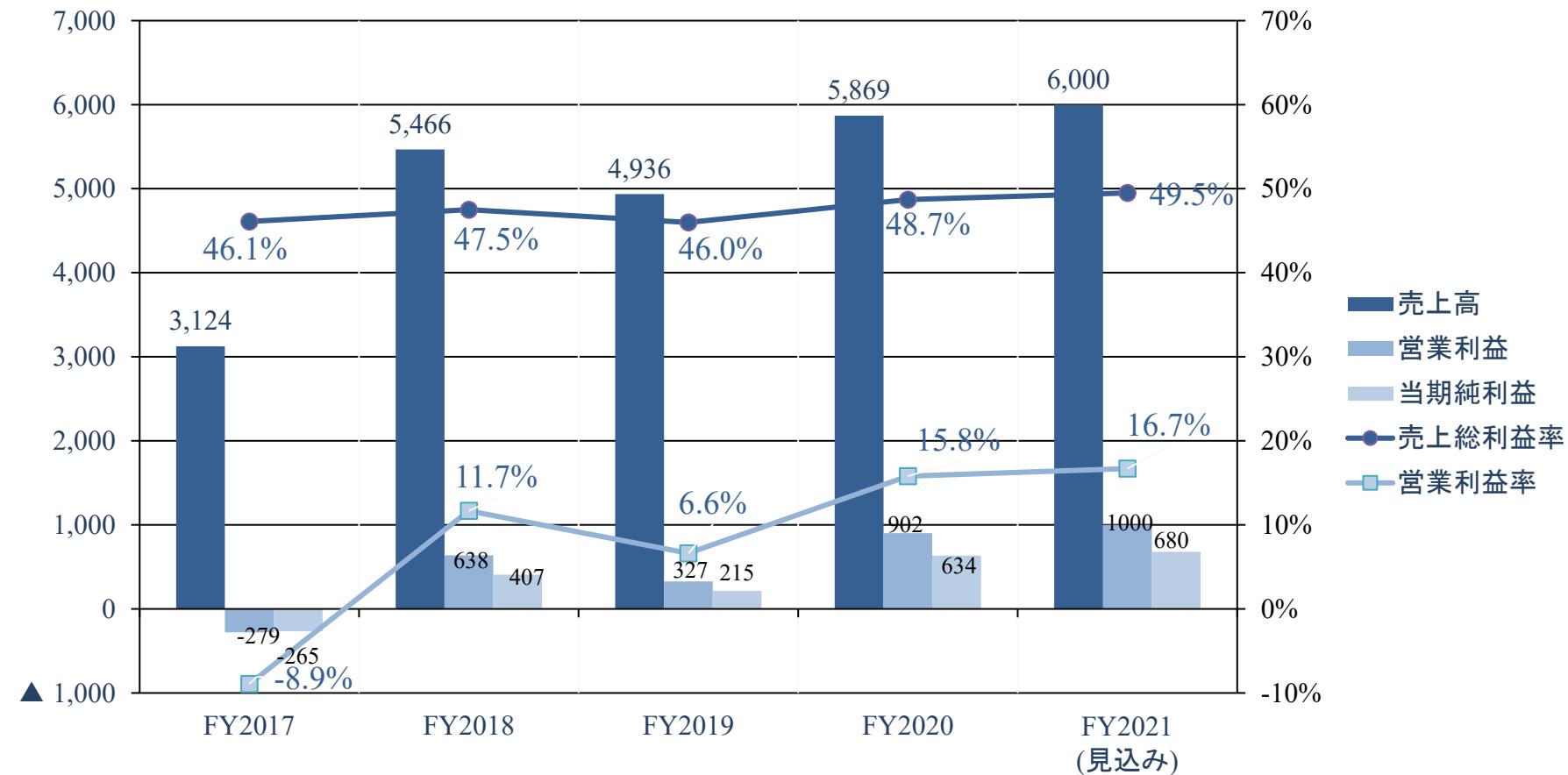
	19/7月期 実績	20/7月期 実績	21/7月期		
			上半期 実績	下半期 計画	通期 計画
売 上 高	4,936	5,869	2,276	3,724	6,000
売上総利益	2,270	2,857	1,169	1,801	2,970
営業利益	327	902	252	748	1,000
経常利益	305	927	262	738	1,000
当期純利益	215	634	191	489	680
海外売上高比率	36.0 %	44.0%			46.7%
ROE	2.6 %	7.4%			7.5%

本資料の著作権その他の一切の権利は、サムコ 株式会社に属しております。

複製、転送、第三者への配布等を無断で行わないようお願い申し上げます。

売上高総利益率／営業利益率

(単位:百万円)

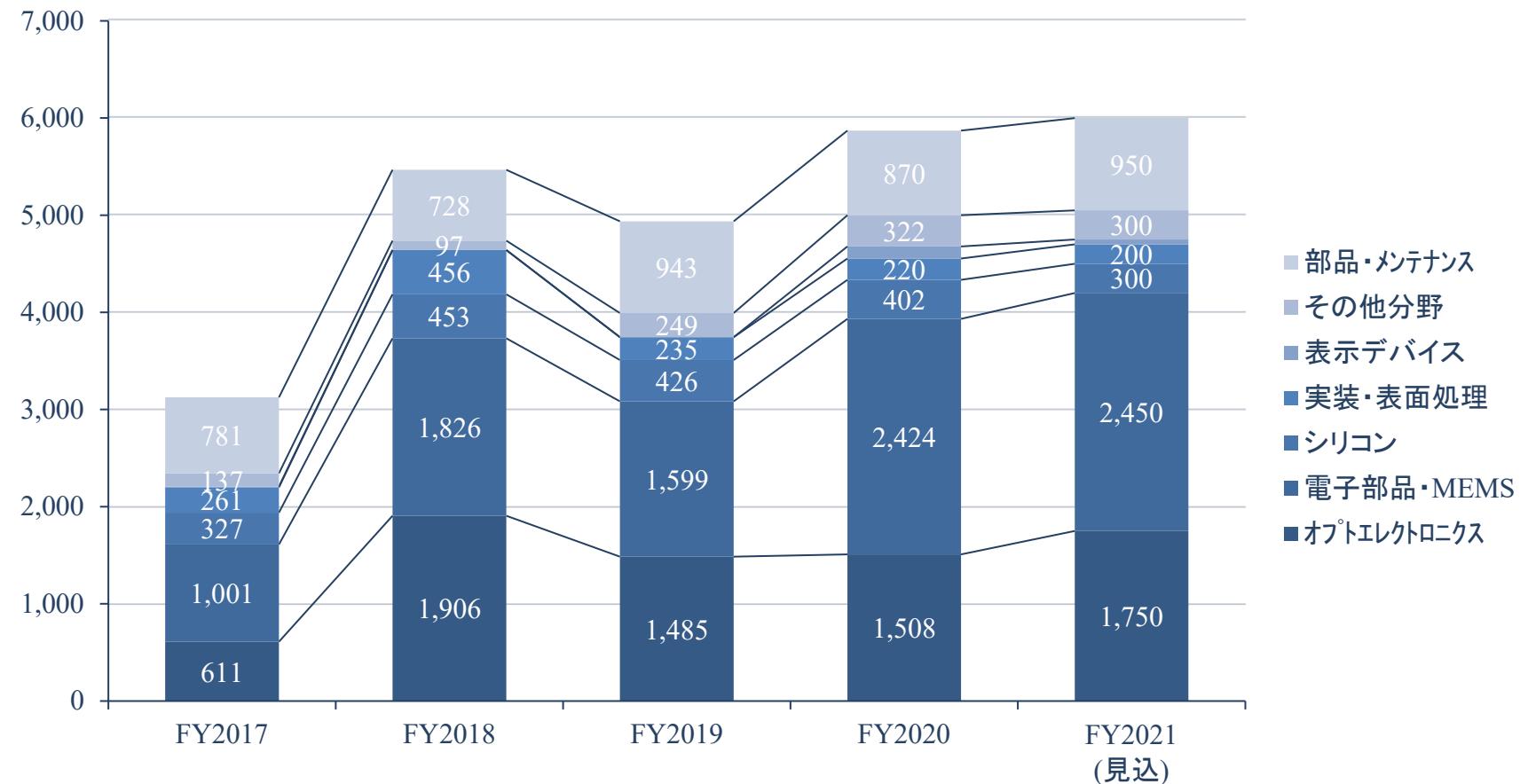


本資料の著作権その他の一切の権利は、サムコ 株式会社に属しております。

複製、転送、第三者への配布等を無断で行わないようお願い申し上げます。

分野別売上高

(単位:百万円)



本資料の著作権その他の一切の権利は、サムコ 株式会社に属しております。

複製、転送、第三者への配布等を無断で行わないようお願い申し上げます。

21/7月期下期 重点施策

① 生産機への取り組み

- 更なる大型生産機の開発、市場投入に注力。

② 出荷済装置のリモート立上

- 本部からのリモート立上に対応できるシステム構築。
- 海外売上高比率50%超えに向けた立上・サービス体制の仕組み。

③ 新規事業(ヘルスケア、メディカル)

- 新型コロナウイルス不活化技術を、滅菌機へ展開。

社会貢献

サムコ科学技術振興財団による若手研究者の助成

「薄膜技術で世界の産業科学に貢献する」という基本理念の下、
薄膜、表面および界面の研究分野の若手研究者を助成。
研究者5名を選定し、それぞれ200万円、総額1,000万円を贈呈。

現在、第5回研究助成募集を受付中。
(2021年3月15日締切)



第4回研究助成金贈呈式

本資料の著作権その他の一切の権利は、サムコ 株式会社に属しております。

複製、転送、第三者への配布等を無断で行わないようお願い申し上げます。



本資料の著作権その他の一切の権利は、サムコ 株式会社に属しております。

複製、転送、第三者への配布等を無断で行わないようお願い申し上げます。

お問合わせ

サムコ 株式会社

広報・IR室

電話 : 075-621-7841

E-mail : koho@samco.co.jp

URL : www.samco.co.jp



薄膜技術で世界の産業科学に貢献する

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

本資料の著作権その他の一切の権利は、サムコ 株式会社に属しております。

複製、転送、第三者への配布等を無断で行わないようお願い申し上げます。